证券代码：301307　　证券简称：美利信　　公告编号：2025-054

重庆美利信科技股份有限公司
关于为全资子公司向金融机构申请项目贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 6 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于为全资子公司向金融机构申请项目贷款提供担保的议案》，同意公司为支持全资子公司深圳市深鼎新半导体有限公司（以下简称“深鼎新公司”）运营发展的需要，拟为深鼎新公司项目贷款无偿提供连带责任保证担保，该笔融资由深鼎新公司向中国银行股份有限公司深圳坪山支行、中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行及招商银行股份有限公司深圳分行等金融机构申请，总额不超过人民币 45,000.00 万元（大写：肆亿伍仟万元整），贷款期限不超过 8 年。

为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权公司董事长或其授权代表根据实际情况在本次担保额度内代表公司签署担保合同及其他相关法律文件、办理相关手续；实际担保金额、期限及担保范围以最终签署的担保合同为准。授权期限同担保额度有效期。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东会审议。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称：深圳市深鼎新半导体有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MAKN7BCRXD

3、成立日期：2026 年 09 月 10 日

4、注册资本：20,000 万元

5、法定代表人：余亚军

6、注册地址：深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道 2007 号创新广场 A2203V 单元

7、经营范围：一般经营项目：电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；淬火加工；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。

8、股权结构：公司持股 100%的全资子公司

9、主要财务数据：截至 2026 年 10 月 31 日（未经审计）：资产总额 362.85 万元、负债总额 0 万元、净资产 362.85 万元；尚处于建设期，暂未实现营业收入，净利润-2.15 万元。

注：深鼎新公司成立于 2026 年 9 月，设立不足一个完整会计年度，尚无最近一年经审计的财务报表。

10、经查询或确认，深鼎新公司不是失信被执行人。

三、担保主要内容

公司拟为深鼎新公司向中国银行股份有限公司深圳坪山支行、中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行及招商银行股份有限公司深圳分行等金融机构申请的项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 45,000.00 万元（大写：肆亿伍仟万元整），担保方式为连带责任保证担保。公司尚未与有关银行签订担保协议，具体担保内容以最终签订的担保协议约定为准。

四、董事会意见

深鼎新公司为公司全资子公司，公司对其经营、财务及资金调度具有完全控制力，本次担保旨在支持其项目建设，符合公司整体利益，担保风险整体可控。

为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权董事长或其授权代表根据实际情况在本次担保额度内代表公司签署担保合同及其他相关法律文件、办理相关手续；实际担保金额、期限及担保范围以最终签署的担保合同为准。授权期限同担保额度有效期。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的实际对外担保余额为人民币 145,922.39

万元（不包含本次），占公司 2025 年期末经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 58.34%。公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保的情形，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日